

runterzuladen unter:

<http://www.amazon.de/dp/B00CLO4PJ0>

oder:

<http://www.amazon.com/dp/B00CLO4PJ0>

ASIN: B00CLO4PJ0

Woerterbuch Mikroelektronik (Halbleitertechnik)

deutsch-englisch

+

kleines Lexikon Leiterplattentechnik in deutsch

Abbildungsverfahren: lichtoptisches Abbildungsverfahren
photo-imaging technique

Abbildungswellenlaenge
imaging wavelength

Abblaettern
to delaminate

abblenden auf
to aperture down to

Abblendschalter {Elektronik}
dip switch

bzw.:

German-english Dictionary of Microelectronics

Leseprobe:

**- Photolack durch Lichtimpulse entfernen
to photoablate resist**

- Masken-Halbleiterscheiben-Kontakt
mask-to-wafer contact

- Masken-Halbleiterscheiben-Positioniersystem
mask-to-wafer positioning system

- Chip mit hochintegriertem Schaltkreis:

LSI [large scale integrated] chip

- Mikrobefehlsregister:
microinstruction register

- Mikrobefehlssprungfeld:
microinstruction jump field

- bonden:
den Chip auf den Montagesockel bonden
to bond the chip to the header

- Defekthalbleiter:
defect [p-type] semiconductor, hole conductor

- Defektkontrollanlage
defect detection system

Bereiche:

- Mikroelektronik / Mikrotechnik
- Leiterplattentechnik
- Begriffe zu elektronischen Schaltungen

- Elektronische Bauelemente (Transistoren, Kondensatoren, Dioden, Widerstaende, Thyristoren, DIAC (diode alternating current switch))
- Technik
- EDV

Impressum:

<http://www.englisch-woerterbuch-mechatronik.de>

ebooks Technische Woerterbuecher + Lexika mechatronik elektronik edv unter:

<http://www.amazon.de/Markus-Wagner/e/B005WGHCEO>

Verlag Lehrmittel-Wagner
Technischer Autor Dipl.-Ing. (FH), Elektrotechnik
Markus Wagner
Im Grundgewann 32a
Germany; 63500 Seligenstadt
USt-IdNr: DE238350635
Tel.: 06182/22908
Fax: 06182843098